

112學年度進修部電子工程系-封裝測試產業精英專班二技課程規劃表

第一學年(112)					第二學年(113)							
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期		
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數	
校 必 修						校 必 修						
	小計						小計					
院 必 修						院 必 修						
	小計						小計					
專 業 必 修	※測試能力鑑定(一)	3	3			專 業 必 修	※封裝能力鑑定(一)	3	3			
	※BIB治具設備操作與維修概論	3	3				※Tester設備操作與維修概論	3	3			
	※Laser Marker設備操作與維修概論	3	3				※Handler設備操作與維修概論	3	3			
	※Lead Scanner原理與應用	3	3				※HF設備操作與維修概論	3	3			
	※半導體製程實務	3	3				※積體電路工程	3	3			
	※實務專題(一)	3	3				※半導體元件	3	3			
	※半導體產業分析			3	3		※半導體製程技術			3	3	
	※實務專題(二)			3	3		※積體電路可靠性工程			3	3	
	※捲帶機原理與應用			3	3		※Oven設備操作與維修概論			3	3	
	※打線機原理與應用			3	3		※LD/UL設備操作與維修概論			3	3	
	※黏晶機設備操作與維修概論			3	3		※治具設備操作與維修概論			3	3	
※測試能力鑑定(二)			3	3	※封裝能力鑑定(二)			3	3			
小計	18	18	18	18	小計	18	18	18	18			
專 業 選 修						專 業 選 修						

注意事項：

- 畢業應修學分為72學分；含必修：_72_學分，選修：_0_學分（選修學分含跨系選修學分），本系專業選修至少_0_學分以上。
- 表列選修課程僅供參考，依實際狀況調整。

項目	學分	時數
校必修		
院必修		
專業必修	72	72
專業選修		
合計	72	72



電子工程系
主任 王木俊

半導體學院
院長 張合

112學年度進修部二技 電子系-封裝測試產業菁英專班必修課程變動表

112學年度科目	第_學年/ 學期	學分/ 時數	112學年度科目	第_學年/ 學期	學分/ 時數	變動類別(停開、新 增、更改課程名稱、 學分)	修訂及重補修原則說明
測試能力鑑定(一)	三上	3/3	測試能力鑑定(一)	四上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
BIB治具設備操作與維修概論	三上	3/3	BIB治具設備操作與維修概論	四上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
Laser Marker設備操作與維修概論	三上	3/3	Laser Marker設備操作與維修概論	四上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
Lead Scanner原理與應用	三上	3/3	Lead Scanner原理與應用	四上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
半導體製程實務	三上	3/3	半導體製程實務	四上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
實務專題(一)	三上	3/3	實務專題(一)	四上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
半導體產業分析	三下	3/3	半導體產業分析	四下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
實務專題(二)	三下	3/3	實務專題(二)	四下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
捲帶機原理與應用	三下	3/3	捲帶機原理與應用	四下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
打線機原理與應用	三下	3/3	打線機原理與應用	四下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
黏晶機設備操作與維修概論	三下	3/3	黏晶機設備操作與維修概論	四下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
測試能力鑑定(二)	三下	3/3	測試能力鑑定(二)	四下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
封裝能力鑑定(一)	四上	3/3	封裝能力鑑定(一)	三上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
Tester設備操作與維修概論	四上	3/3	Tester設備操作與維修概論	三上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
Handler設備操作與維修概論	四上	3/3	Handler設備操作與維修概論	三上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
HIF設備操作與維修概論	四上	3/3	HIF設備操作與維修概論	三上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
積體電路工程	四上	3/3	積體電路工程	三上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
半導體元件	四上	3/3	半導體元件	三上	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
半導體製程技術	四下	3/3	半導體製程技術	三下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
積體電路可靠性工程	四下	3/3	積體電路可靠性工程	三下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
Oven設備操作與維修概論	四下	3/3	Oven設備操作與維修概論	三下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
LD/UL設備操作與維修概論	四下	3/3	LD/UL設備操作與維修概論	三下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
治具設備操作與維修概論	四下	3/3	治具設備操作與維修概論	三下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求
封裝能力鑑定(二)	四下	3/3	封裝能力鑑定(二)	三下	3/3	更改開課時程	提升教學品質及符合課程安排需求

系課務委員簽章：

明新科技大學電子系
課程教學小組

系主任簽章：

電子工程系 王木俊 主任

院長簽章：

半導體學院 張合 院長